

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(记录表编号：2026-004)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别           | <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 一对一沟通</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>                                                                                                                                                                                                                          |
| 时间                      | 2026 年 8 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点/方式                   | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 参与单位或人<br>员（排名不分<br>先后） | 百年保险资产管理、宝盈基金、博普资管、博时基金、博远基金、财通基金、长城财富保险资管、长城基金、长城证券、辰泰顾问、乘是资产、冲积资产、重阳投资、翀云投资、创金合信、大成基金、德邦基金、德邻众福、第一上海证券、东北证券、东方阿尔法基金、东方证券、恩宝集团、方正富邦基金、方正证券、福瑞鼎丰、富安达基金、富国基金、高竹私募、耕霖投资、光大证券、广发证券、国海证券、国华兴益、国金基金、国金证券、国联安基金、国联民生证券、国融基金、国盛证券、国寿安保基金、国泰海通、国泰基金、国泰证券、国投瑞银基金、国投证券、国新证券、国信投资、国信证券、瀚信资产、杭银理财、昊晟基金、浩成资产、禾其投资、和谐健康保险、河床投资、河清投资、黑森投资、红华资本、红杉资本、宏道投资、泓铭资本、鸿途私募、华安财保资管、华安基金、华创证券、华福证券、华泰柏瑞、华泰证券、华西证券、华夏基金、华夏久盈、华夏未来、华源证券、怀信投资、汇正财经、嘉实基金、嘉信天时、健顺投资、碣石私募、锦成盛资产、九祥资产、玖歌投资、聚鸣投资、开源证券、凯丰投资、宽源私募、坤阳私募、理成资产、路博迈、麦格理、美林证券、民森投资、摩根大通证券、摩根士丹利基金管理、南京证券、宁涌富私募、农银汇理、诺安基金、诺德基金、盘京投资、磐厚动量、磐泽资产、鹏安基金、平安基金、平安证券、勤辰私募、清淙投资、趣时资产、筌笠资产、群益证券、荣金资管、融通基金、瑞 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>士银行、睿目投资、润晖投资、山西证券、熵简私募、上海德汇集团、上海汽车集团金控、上海证券、申万菱信基金、申银万国证券、深梧资产、十溢投资、石丸梨花私募、四川发展、素本投资、太平洋证券、太平资产、泰济朝合、泰康基金、腾跃基金、天贝合私募、天弘基金、天治基金、彤源投资、潼骁投资、万家基金、望正资产、微明恒远、西部利得、西部证券、喜世润投资、橡果资产、新华基金、信达澳亚基金、信达证券、星熹元、兴业证券、兴银理财、兴亿投资、循远资产、阳光天泓、怡合达、羿鹏私募、银河基金、银鲨私募、银叶投资、胤胜资管、英大国际信托、永赢基金、甬兴证券、友邦人寿保险、誉辉资本、源乘私募、泽铭投资、展博投资、长江证券、长青藤资产、长盛基金、长信基金、招商信诺、招商证券、招银国际、浙商基金、浙商证券、致合资产、中才中环、中国银河证券、中海基金、中金公司、中金众鑫、中泰证券、中信保诚、中信建投证券、中信证券、中银国际、中银基金、中庸资本、中邮证券、中原证券</p>           |
| <p>上市公司<br/>接待人员</p>    | <p>董事兼总裁：刘羽先生<br/>财务总监：孙君磊先生<br/>董事会秘书：黄恬先生</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>投资者关系<br/>活动主要内容</p> | <p><b>一、经营情况简介</b></p> <p>报告期内，公司保持战略定力，扎实推进各项经营部署，实现营业收入 86.11 亿元，同比增长 21.37%，归属于上市公司股东的净利润 6.02 亿元，同比下降 7.38%；其中，受人民币升值影响，汇兑损失 1.23 亿元，上年同期实现汇兑收益 0.38 亿元，汇兑对公司净利润影响超 1.5 亿元。</p> <p>公司以 AI 算力需求为核心驱动力，加速高端 PCB 产品的技术迭代与市场拓展，战略卡位成效正在逐渐显现，业绩增长动能勃发。2026 年第二季度，公司实现营业收入 47.20 亿元，同比、环比增速均超过 20%；归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿元，同比增长 13.61%、环比增长 58.55%。</p> <p>2026 年上半年，公司在 AI 服务器、高速光模块等高确定性高景气度细分赛道多点突破。</p> <p>AI 服务器与数据中心领域，报告期内，公司为全球 AI 计算基础设施领</p> |

先企业客户批量供应高性能 PCB，应用场景与产品覆盖面持续拓宽。公司品质管控体系运行成熟，过程控制严格，产品良率稳定在行业较高水平，按时交付，获得客户高度认可。随着客户当代产品陆续进入量产交付阶段，相关产品订单快速增长。结合客户交付计划，预计上述订单将使公司现有的 AI 产品工厂满产，对公司未来数个季度的经营业绩形成明确的增量贡献。同时，公司已顺利通过客户下一代产品的量产认证，并紧密配合未来产品的先期开发，满足其高标准要求，抢占先发身位，为后续迭代升级中的供应份额打下坚实基础，经营业绩的积极影响具有较好的延续性。作为核心供应商为全球 AI 计算基础设施领先企业客户稳定、大批量供应高端产品，有助于公司进一步开拓相关市场。截至报告期末，公司已通过国内外主流服务器及云服务器厂商的认证，并逐步实现量产出货。

高速光模块领域，随着公司新增 mSAP 产线安装调试完成，大批量产能落地，报告期内公司已批量交付 800G、1.6T 光模块 PCB，2026 年第二季度，800G 及以上速率光模块收入环比增长近 1500%。公司深度参与多家全球领先客户的高速光模块 PCB 供应，基于客户高度认可公司的技术实力、品质管控和交付保障能力，公司与全球领先客户建立稳固的战略合作伙伴关系，并深度参与未来产品的先期开发、联合技术攻关和前瞻性协同，有望持续受益于本轮结构性增长。

## **二、投资者问答**

**问：预计什么时候能看到一些北美超大型云厂商客户的进展？**

答：截至 2026 年上半年末，公司已通过多家国内外主流服务器及云服务器厂商的认证，并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通，随着公司新增高端产能的落地，预计会在 2027 年获得更多积极进展。

**问：公司高速光模块 PCB 的良率情况？**

答：2026 年上半年，公司高速光模块 PCB 已量产交付，产品综合良率超过 85%，处于行业领先水平，能够有效保障大批量订单的稳定交付。

**问：公司 mSAP 产线的建设情况？**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>答：公司 2022 年在珠海金湾基地 SLP 工厂安装了第 1 条 mSAP 产线。经过多年的布局沉淀，也感谢客户在过程中的支持，公司积累了不少经验教训，这也侧面印证了 mSAP 的进入门槛较高。2025 年底，公司判断光模块 mSAP 产能或将面临巨大瓶颈，于是决策在 SLP 工厂增加 mSAP 产线。目前公司的 3 条 mSAP 产线已实现良好运行，产能利用率较高，第 4 条线将在近 1-2 周内安装完毕，第 5 条线在 10 月基本安装完毕。得益于此前多年的积累，公司新建 mSAP 产线的产能爬坡和良率提升较为顺利。</p> <p><b>问：公司在 3.2T、NPO、XP0 等未来应用场景的储备情况？</b></p> <p>答：3.2T、NPO、XP0 等未来应用场景的技术方案目前处于与客户先期开发、联合技术攻关和前瞻性协同阶段，工艺路径迭代优化。公司在 mSAP 技术上具备成熟的量产经验和技術沉淀，特别是 800G、1.6T 光模块 PCB 的规模化交付上具备领先优势。mSAP 正向 3.2T、NPO、XP0 等未来场景加速延伸，技术工艺具有较高壁垒，公司依托自身积累，具备天然协同优势。</p> <p><b>问：SLP 工厂、HLC 工厂的产能利用率？</b></p> <p>答：SLP 工厂和 HLC 工厂近期的主要产品为 AI 服务器 PCB 和高速光模块 PCB，产能利用率较高。现有产能及未来数月内开出的新增产能，将无法充分覆盖客户快速增长的交付需求。为保障核心客户订单的持续稳定交付，公司已启动面向 AI 算力超高多层 PCB 的建设。</p> <p><b>问：公司此次追加投资超高多层 PCB 智能制造项目的主要原因和变化？</b></p> <p>答：公司此次将强化关键工序产能的项目调整为超高多层 PCB 项目，主要是审慎判断行业技术发展趋势、市场需求增长、客户的需求规划指引所作出的调整，预计总投资上调为人民币 43.88 亿元，将打造行业顶级的超高多层 PCB 智能制造工厂，满足 AI 算力基础设施领域对超高多层 N+N\N+M\M+N+M 结构 PCB 的规模化需求。目前客户对超高多层产品的需求明确，公司已为本次项目建设提前做了很多准备，相信很快会有相关产能逐步释放，支撑客户需求。</p> <p><b>问：公司对高阶 HDI 工厂、高多层工厂及泰国基地几个重要在建工厂的产能释放节奏展望？</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>答：高阶 HDI 工厂目前已在试运行阶段，预计今年 10 月全线拉通投产；超高多层工厂预计可在今年底试产部分关键工序、明年一季度具备量产条件；泰国基地一期工厂预计今年 9 月全线拉通。基于行业技术发展趋势、市场需求增长、客户的产品交付计划，公司对上述工厂的新增产能的消化充满信心，正加快推进相关工作，争取早日投产，满足客户产品的量产需求。</p> <p><b>问：公司在 PTFE 材料上是否有技术积累？</b></p> <p>答：公司拥有多年的加工 PTFE 材料的丰富经验，已实现在车载毫米波雷达、通信基站、高速网络通信等领域的批量出货，并且与不同领域头部客户长期合作预研产品。</p> <p><b>问：如何判断通用覆铜板的价格走势？</b></p> <p>答：公司与上游原材料供应商之间的合作，注重长期稳定的供应关系与品质保障，而非单纯围绕价格的短期博弈。公司采购规模较大，与核心供应商建立了长期战略合作关系，在合作过程中，供应商亦优先保障公司的产能资源与品质稳定。因此，公司对原材料价格的短期波动保持平常心，更关注长期共赢与供应链韧性。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 记录时间 | 2026 年 8 月 24 日整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |